

2021 年 12 月 17 日

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社

品質保証部

部長 長沼裕之



Emboss 出荷品の包装仕様の追加について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、現在貴社にご採用いただいております製品につきまして、
納入時に使用する包装仕様を追加させていただきます。
変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

敬 具

- 記 -

1. 対象製品

- ・ SOP8 (150mil) パッケージで、Emboss Tape 包装形態で納入している製品
MB85RC04PNF-G-JNERE1、 MB85RC04VPNF-G-JNERE1、 MB85RC128APNF-G-JNERE1
MB85RC16PNF-G-JNERE1、 MB85RC16SPNF-G-JNERE1、 MB85RC16VPNF-G-JNERE1
MB85RC16VPNF-G-JNN1ERE1、 MB85RC1MTPNF-G-JNERE1、 MB85RC256VPNF-G-JNERE1
MB85RC512TPNF-G-JNERE1、 MB85RC64APNF-G-JNERE1、 MB85RC64PNF-G-JNERE1
MB85RC64VPNF-G-JNERE1、 MB85RS128APNF-G-JNERE1、 MB85RS128BPNF-G-JNERE1
MB85RS16PNF-G-JNERE1、 MB85RS16PNF-G-JNERE1、 MB85RS1MTPNF-G-JNERE1
MB85RS256APNF-G-JNERE1、 MB85RS256BPNF-G-JNERE1、 MB85RS512TPNF-G-JNERE1
MB85RS64PNF-G-JNERE1、 MB85RS64TPNF-G-JNERE2、 MB85RS64TUPNF-G-JNERE2
MB85RS64VPNF-G-JNERE1
- ・ SOP8 (208mil) パッケージで Emboss Tape 包装形態で納入している製品
MB85RC256VPF-G-JNERE2、 MB85RS2MTPF-G-JNERE2、 MB85RS4MTPF-G-JNERE2
- ・ SOP28 パッケージで Emboss Tape 包装形態で納入している製品
MB85R256FPNF-G-JNERE2

2. 追加内容

- ・ 防湿アルミラミネート袋の仕様追加
- ・ 湿度インジケータの仕様追加
- ・ 内装箱の仕様追加

3. 追加理由

対象製品の現行包装仕様は弊社専用仕様の為、現在の半導体市況で、安定した調達が難しくなっています。その為、安定した製品納入を継続できるよう、委託先で汎用として使用している包装仕様も追加し、「現行仕様と追加仕様」の併用にて納入とさせていただきます。ご理解とご協力をお願い致します。

4. 追加予定時期

2022 年 3 月中旬以降の納入より適用させていただきます。

5. 追加する包装仕様

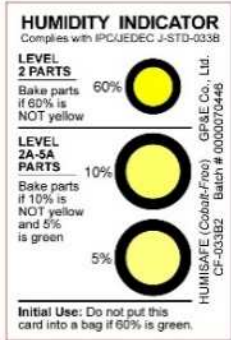
各追加仕様については、次頁にあります現行仕様と追加仕様内容を参照願います。
なお、仕様追加による製品の品質、保証に変更はございません。

現行仕様と追加仕様内容

□防湿アルミラミネート袋 現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
外形サイズ	幅:380, 長さ:450, 厚:0.09 mm	幅:390, 長さ:500, 厚:0.15 mm
外観		

□湿度インジケータ 現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
検知湿度	30%	5% 10% 60% (JEDEC 準拠)
外観		

□内装箱 現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
外観	印字デザインだけが異なります。外形サイズに相違はありません。	
		
	FUJITSU ロゴ あり FUJITSU マーク あり	FUJITSU ロゴ なし FUJITSU マーク なし

以上